

●USP-8B10 パッケージ許容損失

USP-8B10 パッケージにおける許容損失特性例となります。

許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため、下記実装条件にての参考データとなります。

1.測定条件 (参考データ)

測定条件：基板実装状態

雰囲気：自然対流

実装：Pb フリーはんだ

実装基盤：銅箔 4 層基板 76.2mm × 114.3mm

(片面約 8700mm²) に対して銅箔面積

1 層目：50mm × 50mm_放熱板と接続有

2 層目：70mm × 70mm_放熱板と接続有

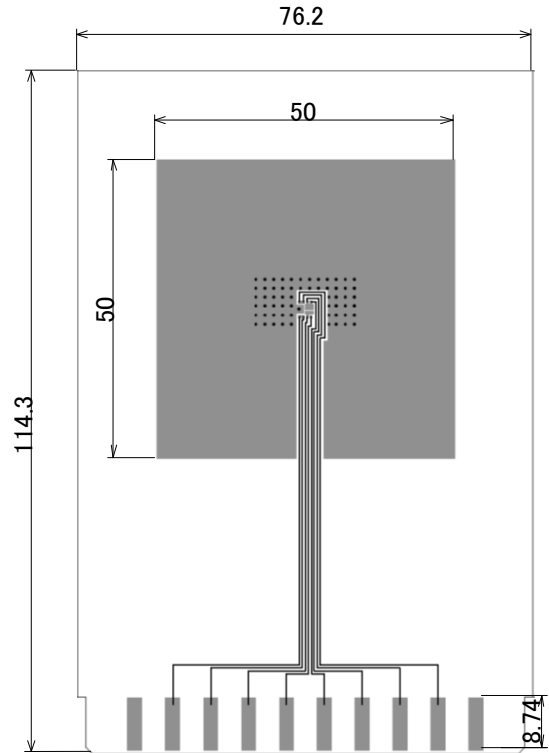
3 層目：70mm × 70mm_放熱板と接続有

4 層目：50mm × 50mm_放熱板と接続有

基板材質：ガラスエポキシ (FR-4)

板厚：1.6mm

スルーホール：φ0.2mm 60 個



評価基板レイアウト(単位:mm)

2. 許容損失-周囲温度特性

基板実装($T_{jmax}=125^{\circ}\text{C}$)

| 周囲温度(°C) | 許容損失 Pd (mW) | $\theta_a(^{\circ}\text{C}/\text{W})$ |
|----------|--------------|---------------------------------------|
| 25 | 1400 | 71.43 |
| 85 | 560 | |

